

# 50-300毫米光学玻璃 半导体封装材料 印刷电路板金刚石切片

产品名称	50-300毫米光学玻璃 半导体封装材料 印刷电路板金刚石切片
公司名称	郑州三磨新磨具磨料有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:三磨新 型号:1A1/3,1A1R/4,1A1/5,1A1R/6 粒度:60目-600目以细
公司地址	郑州市中原区建设西路珍岗大厦0235
联系电话	56009066 17703816980

## 产品详情

基体型切割砂轮是指砂轮外圆环带为磨料工作层,而中心部分为高强度高刚性金属材料,也称作外环型切割砂轮.这种砂轮一般稍厚,刚性好,转速低,一般转速为3000-10000 rpm,多用于较低转速下大切深的切槽和切断.

适用:晶圆、晶粒精密切割,半导体封装后分切,光学玻璃、石英玻璃管、蓝宝石切割,印刷电路板切割加工,精密陶瓷材料加工。特质:高精度、高寿命、高效率切断和开槽,减少裂角、崩边、缺口、产品长短不一之发生。特点:使用强度、刚性特优基板;采用锐利度、形状保持力皆佳的专用结合剂。特别适合组合切割产品规格:外径(mm):76.2

内径(mm):40

金刚石层厚度(mm)0.3、0.25、0.2、0.15

金刚石层精度在 $\pm 0.002$ 以内,

产品优势：

金属结合剂把持磨料能力强，耐磨性高，砂轮形状保持性好，使用寿命长

常用粒度：

特粗	80# 100#
粗	120# 140# 170#
中	200# 230# 270#
细	400# 500# 600#
特细	800#以细

型号: 1a1/3, 1a1r/4 1a1/5 1a1r/6.

1a1/3 1a1r/4是指基体型切割片外圆不带水槽. 1a1/5 1a1r/6外圆带水槽

规格：单位：毫米

直径(d)：100，110，125，150，175，180，200

内孔(h)：12.7，25.4，31.75，40，50.8

厚度(t): 0.4，0.5，0.6，0.8，1.0，1.2，1.5

金属结合剂金刚石切割片可供规格：

外径(mm)	内径(mm)	厚度(mm)	粒度
50-300	10-70	0.15-2.2	60-600

特殊规格，可根据用户需求加工

在订货时，我们可根据不同加工要求，协助您选择最适合的切割砂轮。届时请用户提供：

型号（1a8、1a1、1a1r、1b1等）

尺寸（外径、厚度、内径、工作层宽度、基体厚度等）

规格（磨料、粒度、结合剂等）

用途（工件名称、材质牌号及硬度、工件尺寸、切槽或切断等）

使用条件（机床型号、切片转速、工件转速、进给量、切割速度、切割深度；干式切、湿式切等）

切割要求（切割精度、崩口要求、表面完整性、表面粗糙度要求、砂轮寿命等）

特殊要求（如：是否组刀使用、树脂切割砂轮是否需要导电、基体型切割砂轮外圆是否带水槽、1a1型切割砂轮基体外侧面是否有排屑槽等）

## 超薄金刚石切割片加工范围

玻璃材料:各种玻璃管/光学玻璃/石英玻璃/微晶玻璃/宝石/水晶

陶瓷材料:氧化铝/氧化锆/黑陶瓷/琉璃制品/陶管/耐火材料等

磁性材料：磁芯/磁片/稀土钕铁硼/永磁铁氧体等

半导体材料：碳化硅/硅片/太阳能电池

金属材料:高速钢、模具钢、合金钢等

脆金属材料: 硬质合金（钨钢）等

光电材料: led/ lcd/ mp3

本产品的品牌是三磨新，型号是1A1/3,1A1R/4,1A1/5,1A1R/6，粒度是60目-600目以细，外径是76.2（mm），内径是40（mm），厚度是0.12-2.2（mm），材质是金刚石，最大线速度是70（rpm），适用范围是晶圆，晶粒精密切割，半导体封装才来哦分切，光学玻璃，精密陶瓷，印刷电路板切槽或切断，加工定制是是，规格是76.2\*0.12\*40，结合剂是金属结合剂